

中国集成电路设计业 2015 年会暨
天津集成电路产业创新发展高峰论坛
CSIA-ICCADC 2015 Annual Conference &
Tianjin IC Industry Innovation and Development Summit
会议日程
Agenda

2015 年 12 月 10 日，星期四
December 10, Thursday, 2015

地点：天津梅江会展中心一楼 N4 多功能厅

Venue: Multiple-function hall N4, 1/F, Tianjin Meijiang Convention & Exhibition Center

时 间 Time	内 容 Contents
开 幕 式 Opening Ceremony	
主持人：天津市科委 Moderator:	
08:30-08:55	天津市政府领导致开幕词 Address, Tianjin Municipal Government 中国半导体行业协会执行副理事长徐小田先生致词 Mr. Xu Xiaotian, Executive Vice General Director, CSIA 国家发改委领导致词 Address, NDRC 科学技术部领导致词 Address, MOST 工业和信息化部领导致词 Address, MIIT
高峰论坛 Top Forum	
主持人：中国半导体行业协会集成电路设计分会秘书长 程晋格先生 Moderator: Mr. Cheng Jingge, General Secretary, CSIA-ICCADC	
08:55-09:25	主旨报告 — 中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长 魏少军教授 — Prof. Wei Shaojun, General Director, CSIA-ICCADC
09:25-09:55	主旨报告 — 天津市科委
09:55-10:20	面向物联网、汽车电子、云计算的完整工艺平台 — TSMC 中国业务发展副总经理 罗镇球先生 Technology Platform for Future Applications — Mr. Roger Luo, Vice President, Business Development, TSMC
10:20-10:45	“万物互联，质·量·为先” — 物联网时代半导体企业的致胜关键 — Mentor Graphics 全球副总裁，亚太区总裁 彭启煌先生 “Time to Quality & Quantity” – The Essence of Success in the IoT Era — Danny Peng, Corp. Vice President, PacRim Managing Director, Mentor Graphics
10:45-11:10	面向物联网的芯片设计平台即服务（SiPaaS） — 芯原股份有限公司董事长，总裁兼首席执行官 戴伟民博士

	<p>Silicon Platform as a Service (SiPaaS) for IoT</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dr. Wayne Dai, Chairman, President and CEO, VeriSilicon Holdings Co., Ltd.
11:10-11:35	<p>Cadence 在新时代助您领先一步</p> <ul style="list-style-type: none"> – Cadence 公司全球副总裁, 亚太区总裁 石丰瑜先生 <p>As Leader in Intelligence World with Cadence</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mr. Michael Shih, Corporate Vice President, Asia Pacific Region, Cadence Design Systems, Inc.
11:35-12:00	<p>物联网: 从芯片到软件的新要求</p> <ul style="list-style-type: none"> – 新思科技总裁兼联合首席执行官 陈志宽博士 <p>IoT: New Requirements from Silicon to Software</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dr. Chi-Foon Chan, President & co-CEO, Synopsys
12:00-13:25	自助午餐 Buffet Lunch
<p>主持人: 中国半导体行业协会 IC 设计分会第一副理事长 严晓浪教授</p> <p>Moderator: Prof. Yan Xiaolang, Chief Vice General Director, CSIA-ICCAD</p>	
13:25-13:30	幸运抽奖 Lucky Draw
13:30-13:55	<p>晶圆专工在物联网世界的角色</p> <ul style="list-style-type: none"> – 联华电子股份有限公司市场营销暨特殊制程研发副总经理 简山傑先生 <p>I.O.T. Foundry</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mr. Chien, ShanChieh, VP Of Corporate Marketing & Specialty Technology Development, UMC
13:55-14:20	<p>合作共赢大数据时代</p> <ul style="list-style-type: none"> – 中芯国际集成电路制造有限公司全球市场部资深副总裁 许天榮先生 <p>Collaborate to Win in Big Data Era</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mr. Sunny Hui, Senior Vice President, Worldwide Marketing, SMIC
14:20-14:45	<p>芯系中国梦, 共建创新生态与中国产业共成长</p> <ul style="list-style-type: none"> – ARM 全球执行副总裁兼大中华区总裁 吴雄昂先生 <p>“Core” of China Dream - Grow with China and Enable Open Innovation</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mr. Allen Wu, EVP and President of Greater China, ARM
14:45-15:10	<p>科创引领智造</p> <ul style="list-style-type: none"> – 上海华力微电子有限公司市场部总监 刘子明先生 <p>Scientific and Technological Innovation Leads Intelligent Manufacturing</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mr. Henry Liu, Senior Director, Marketing, Shanghai HLMC
15:10-15:25	茶歇, 交流 Coffee Break
15:25-15:30	幸运抽奖 Lucky Draw
15:30-15:55	<p>先进制程介绍 – 为您所需</p> <ul style="list-style-type: none"> – 格罗方德半导体科技(上海)有限公司 Michael Mendicino 先生 <p>Advanced Node Technologies - Making the Right Choice</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mr. Michael Mendicino, Senior Director, CMOS Platforms Business Unit, GLOBALFOUNDRIES
15:55-16:20	<p>新产业环境下的本土EDA</p> <ul style="list-style-type: none"> – 北京华大九天软件有限公司运营副总 杨晓东先生 <p>Domestic EDA in new industry environment</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mr. Steve Yang, Operation VP, Huada Empryean Software Co., Ltd.
16:20-16:45	<p>先进封装助力智能硬件发展</p> <ul style="list-style-type: none"> – 苏州晶方半导体科技股份有限公司副总经理 刘宏钧先生 <p>Advanced packaging to give you better vision, sense and security</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mr. Russell Liu, VP, China Wafer Level CSP Co., Ltd.

16:45-17:10	<p>搭载“中国制造 2025”，打造领先的汽车“中国芯”</p> <ul style="list-style-type: none"> – 大唐恩智浦半导体有限公司首席执行官，总经理 张鹏岗先生 <p>Conform to Made in China 2025 to build into world's leading automotive semiconductor company</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mr. Paul Zhang, CEO, Datang NXP Semiconductors Co., Ltd.
17:10-17:35	<p>集成电路设计产业并购整合讨论</p> <ul style="list-style-type: none"> – 飞思卡尔强芯（天津）集成电路设计有限公司总经理 仇雨菁女士 <p>IC Design Industry Merger & Integration Discussion</p> <ul style="list-style-type: none"> – Maggie Qiu, General Manager, Freescale Qiangxin (Tianjin) IC Design Co., Ltd.
17:35-17:40	<p>幸运抽奖 Lucky Draw</p>
18:30-20:30	<p>欢迎晚宴（北京华大九天软件有限公司赞助）</p> <p>Welcome Dinner Banquet (Sponsored by Empyrean)</p> <p>地点：万丽天津宾馆大宴会厅</p> <p>Site: Renaissance Tianjin Lakeview Hotel</p>

2015 年 12 月 11 日, 星期五
Dec 11, Friday, 2015
专题论坛 (一)
Subject Forum (I)

地点: 天津梅江会展中心二楼 213 会议室

Venue: Meeting Room 213, 2/F, Tianjin Meijiang Convention & Exhibition Center

时 间 Time	内 容 Contents	演讲人 Lecturer
EDA、IP 与 IC 设计服务 EDA and IC Design Service		
主持人: 中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长, 周生明先生 Moderator: Mr. Zhou Shengming, Vice General Director, CSIA-ICCAD		
08:40-09:05	新一代光通信前端智能化光收发集成电路系列的发展 The Development on New generation of Optical Transceiver ASIC	厦门优迅高速芯片有限公司首席科学家, 黄以明 Huang Yiming, Chief Scientist, XIAMEN UX HIGH-SPEED IC CO., LTD
09:05-09:30		新思科技公司
09:30-09:55	迎接 16nm 时代 SoC 时钟、时序和功耗挑战 The Clock, Timing and Power Optimization Solutions at the 16nm node	北京华大九天软件有限公司物理设计事业部经理, 董森华 Senhua, Dong, Department Manager, Physical Design BU, Huada Emperyean Software Co., Ltd.
09:55-10:20	企业级硬件仿真平台 Palladium Z1 带来下一代数据中心级仿真解决方案 New Era of Datacenter-class Emulation with Palladium Z1 Enterprise Emulation Platform	Cadence 公司亚太区系统解决方案暨验证平台总监, 张永专 Simon Chan, Director of System Solution and Verification Platform, Asia Pacific, Cadence
10:20-10:45	FD-SOI — 适用于物联网的低功耗技术 FD-SOI — Low Energy Technology for IoT	芯原微电子(上海)有限公司基础 IP 及版图设计资深总监, 金小卫 Shirley Jin, Sr. Director, Foundation IP and Layout, VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
10:45-11:10	从现实到虚拟, 和 Veloce 一起改变你的验证流程 Real 2 Virtual, go with Veloce change your verification flow	Mentor Graphics 仿真部门技术经理, 张俊 Justin Zhang, Technical Manager, Emulation Division, Mentor Graphics
11:10-11:35	仿真驱动智能物联网产品设计 Simulation Driven smart Internet of Things (IoT) Product Development	ANSYS 公司主任应用工程师, 赵常 Zhao Chang, Lead Application Engineer, ANSYS Inc.
11:35-12:00	先进存储器设计的高精度电路仿真和验证 High accurate circuit verification and signoff for advanced memory designs	概伦电子科技有限公司市场副总裁, 杨廉峰 Lianfeng Yang, Marketing VP, ProPlus Design Solutions, Inc.

12:00-12:05	幸运抽奖Lucky Draw	
12:05-13:00	自助午餐 Buffet Lunch	
主持人：中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长，张力天先生 Moderator: Mr. Zhang Litian, Vice General Director, CSIA-ICCAD		
13:00-13:25	从工艺建模、设计仿真到电路测试 – 是德科技提供 IC 全面解决方案 From Modeling, simulation to test - Full IC solution from Keysight	是德科技（中国）有限公司大中华区市场部经理，任彦楠 Ren Yannan, Marketing development manager, Keysight Technologies
13:25-13:50	壹晶半导体设计和制造服务 eSilicon Semiconductor Design & Manufacturing Solutions	壹晶半导体资深客户市场经理，罗志华 Elwin Luo, Sr. Client Marketing Manager, eSilicon
13:50-14:15	面向物联网（IOT）应用的高能效嵌入式CPU Power efficient embedded processor for IoT applications	杭州中天微系统有限公司首席技术官，孟建熠 Meng Jianyi, CTO, C-SKY Microsystems CO.,LTD
14:15-14:30	茶歇，交流 Coffee Break	
14:30-14:55	物联网时代的智能硬件 The Smart hardware in Internet of things	中国科学院 EDA 中心主任，陈岚 Chen Lan, Director, EDA Center of Chinese Academy of Sciences
14:55-15:20	Robei 可视化芯片设计软件和自适应芯片 Robei Visual Chip Design Software and Adaptive Chip	青岛若贝电子有限公司总裁，吴国盛 Wu Guosheng, CEO, Robei LLC
15:20-15:50	未来物联网创新平台解决方案 Innovation Platform Solution for the Future IoT	灿芯半导体（上海）有限公司首席技术官，庄志青 John Zhuang, CTO, Brite Semiconductor (Shanghai) Corporation
15:50-16:15	定制您自己的“芯” Custom Build Your Chips	北京芯诣世纪科技有限公司销售总监，李伟 Andrew Li, Sales Director, Beijing StarChip Technologies, Inc.
16:15-16:40	快速实现系统开发的基带芯片设计套件 Baseband IC Design Kits for Rapid System Realization	展讯通信（上海）有限公司硬件部高级副总裁，罗强 John Rowland, SVP of Hardware Engineering, Spreadtrum
16:40-16:45	幸运抽奖 Lucky Draw	
18:00-20:00	闭幕招待晚宴 Closing Reception Banquet 地点：天津赛象酒店 Site: Tianjin Saixiang Hotel	

2015 年 12 月 11 日, 星期五
Dec 11, Friday, 2015
专题论坛 (二)
Subject Forum (II)

地点: 天津梅江会展中心二楼 214 会议室

Venue: Meeting Room 214, 2/F, Tianjin Meijiang Convention & Exhibition Center

时 间 Time	内 容 Contents	演讲人 Lecturer
IP 与 IC 设计 IP and IC Design		
主持人: 中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长, 高松涛先生 Moderator: Mr. Gao Songtao, Vice General Director, CSIA-ICCAD		
08:40-09:05	物联网应用: 可靠、信赖与安全的内嵌式 NVM 解决方案 Trustworthy Logic NVM Solutions for Various IoT Applications	力旺电子营销副处长, 郭东政 Steve Kuo, Marketing Deputy Director, eMemory
09:05-09:30	视频编解码发展趋势 Video Codec Trend	芯媒半导体(上海)有限公司中国区销售总经理, 王田 Wang Tian, China Country Manager, Chips&Media, Inc.
09:30-09:55	Arteris NoC Adoption in Automotive and IoT	美国安通思控股有限公司技术支持, 曾品翰 William Tseng, Solutions Architect, Arteris Inc.
09:55-10:20	IC 技术创新实现智能生活 IC Innovations Enable New Smart Life	安谋电子科技(上海)有限公司中国区 FAE 总监, 刘澍 William Liu, FAE Director, ARM China
10:20-10:45	高速接口及超低功耗 IP 应用解决方案 The High Speed Interface and ULP IP Solutions	北京华大九天软件有限公司 IP 与设计服务事业部总监, 刘寅 Liu Yin, Senior Director, IP & Design Service BU, Huada Empryean Software Co., Ltd.
10:45-11:10	如何在 28/14 纳米工艺上轻松集成芯动高速接口 IP Smooth Integration of Innosilicon Interface IP at 28/14nm	芯动科技有限公司 CEO, 敖海 Gordon Ao, CEO, Innosilicon Technology Ltd.
11:10-11:35	物联网的低功耗设计挑战 Low Power Challenges of IoT	创意电子股份有限公司资深副总经理, 梁景哲 CJ Lian, R&D Senior Vice President, GUC
11:35-12:00	嵌入晶心核, 万物皆联网 Embedding Andes, Connecting Everything	晶心科技股份有限公司部经理, 谢幼龄 Amanda Hsieh, Deputy Manager, Andes Technology Corporation
12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw	

12:05-13:00	自助午餐 Buffet Lunch	
主持人：中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，王志华教授 Moderator: Prof. Wang Zhihua, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD		
13:00-13:25	M31 物联网硅智财解决方案 Ultra-Low Power IP Solutions for IoT	円星科技副总经理，石维强 Willis Shih, Vice President, M31 Technology
13:25-13:50	从 IoT 到网通应用，智原经验与方案，加速您的产品问世 From IoT to Networking, Faraday Experience and Solutions Enable Your Fast Time to Market	智原科技股份有限公司业务行销副总经理，于德洵 Remi Yu, Vice president of Business and Marketing, Faraday Technology Corporation
13:50-14:15	Imagination IP 助力下一波创新 New thinking for the next wave of innovation	进想科技（上海）有限公司中国销售总监，温宵恺 Walter Wen, China Sales Director, Imagination Technologies
14:15-14:30	茶歇，交流 Coffee Break	
14:30-14:55	在晶圆代工业内领先的嵌入式闪存方案 Leading edge embedded flash solution in foundry industry	常忆科技股份有限公司资深协理，林志光 JK Lin, Senior Directo, Chingis Technology Corporation
14:55-15:20	射频模拟无源系统芯片化技术 — IPD Chip Level Integrated Passive System Design - IPD	苏州芯禾电子科技有限公司创始人、工程副总裁，代文亮 Dai Wenliang, Founder & VP Engineering, Xpeedic Technology
15:20-15:50	物联网时代系统芯片的设计需求 Design needs of SoC in IoT	无锡华大国奇科技有限公司总裁，谷建余 Jianyu Gu, President, Qualchip Technologies, Inc.
15:50-16:15	智能互联世界的IP解决方案 IP solutions for connected smart world	美国思华科技有限公司高级技术支持经理，陈昊 Chen Hao, Sr. FAE Manager, CEVA
16:15-16:40	低功耗小面积的 16/32 位处理器助力物联网应用 Choosing the Right CPU Core for IoT and Wearable Sensor Nodes	宏太科技股份有限公司业务经理，黄孝衡 Norman, Sales Manager, Avant Technology Inc.
16:40-17:05	Power Management in IoT	Kilopass Technology 市场战略总监，居礼 Lee Chu, VP of Strategic Accounts, Kilopass Technology
17:05-17:10	幸运抽奖 Lucky Draw	
18:00-20:00	闭幕招待晚宴 Closing Reception Banquet 地点：天津赛象酒店 Site: Tianjin Saixiang Hotel	

2015 年 12 月 11 日, 星期五
Dec 11, Friday, 2015
专题论坛 (三)
Subject Forum (III)

地点: 天津梅江会展中心二楼 215 会议室

Venue: Meeting Room 215, 2/F, Tianjin Meijiang Convention & Exhibition Center

时 间 Time	内 容 Contents	演讲人 Lecturer
FOUNDURY 与工艺技术 Foundry and Manufacturing Process Technology		
主持人: 中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长, 何晓宁先生 Moderator: Mr. He Xiaoning, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD		
08:40-09:05	TSMC 先进工艺技术方案 TSMC Advanced Process Technology Solution	TSMC 中国业务发展经理, 林锦瑜 Sarah Lin, Account Manager, Business Development, TSMC
09:05-09:30	晶圆专工在物联网上的特殊工艺平台 IoT Drive Specialty Technology	联华电子股份有限公司中国销售资深处长, 林伟圣 W S Lin, Senior Director, China Sales, UMC
09:30-09:55	手机电源管理相关晶片最佳解决方案 How to Pick the Best Silicon Technology for Your "Mobile-to-Wall" Power Designs	格罗方德半导体科技(上海)有限公司, Michael Sun Michael Sun, Sr. Director, Analog / Power Product Line Management, GLOBALFOUNDRIES
09:55-10:20	助力 IC 设计 - 中芯国际工艺技术分享 Enabling Your Design Possibility – SMIC Technology Introduction	中芯国际集成电路制造有限公司先进工艺及传感市场总监, 吴耿源 KY Wu, Director of Advanced Technology & CVS3D Application Marketing, SMIC
10:20-10:45	华力微电子平台技术及差异化特色工艺技术 HLMC Platform Technology and Differentiated Specialty Technology	上海华力微电子有限公司研发一部总监, 邵华 Chris Shao, Senior Director, TD Division 1, Shanghai Hua Li Microelectronics Corporation
10:45-11:10	针对超低功耗应用的 Deeply Depleted Channel 设备的性能设计 Characteristic Design of Deeply Depleted Channel Device for Ultra-Low-Power Applications	三重富士通半导体股份有限公司工艺开发统括部第一集成技术部部长, 三泽信裕 Nobuhiro Misawa, Director of Process Integration Depart- I, Process Technology Division, MIE Fujitsu Semiconductor Limited

11:10-11:35	深耕特色创新，助力物联网智能硬件市场腾飞 Innovation in Specialty Technologies to Boost IoT Hardware Market	上海华虹宏力半导体制造有限公司销售与客户支持副总裁，陈卫 Tony Chen, Vice President of Sales and Customer Support, Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation
11:35-12:00	日本质量服务中国市场 — 来自日本的 3 座纯 foundry 工厂 Japanese Quality Serves China Market, from three fabs with pure foundry service in Japan	TowerJazz，岡田直樹 Naoki Okada, Manager of Design Enablement Team, TowerJazz
12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw	
12:05-13:00	自助午餐 Buffet Lunch	
13:00-13:25	物联网产品设计所需要的启动组件 Design Enablement For IoT Era	联华电子股份有限公司市场营销处长，庄学亮 Chuang Bill, Director Corporate Marketing, UMC
13:25-13:50	用传感器技术打造更加美好的世界 Sharping The World With AMS Senors Technology	奥地利微电子市场部经理，周之琦 Zhou Zhiqi, Marketing Manager, AMS AG
13:50-14:15	MOSIS 流片服务为中国集成电路创新事业推波助澜 MOSIS Tapeout Service Customized for IC Innovation in China	MOSIS 专业流片服务机构业务拓展经理，袁泉 YuanQuan, Business Development Manager, The MOSIS Service
14:15-14:30	茶歇，交流 Coffee Break	
TSMC 专场 - 智能物联网的全方位工艺解决方案 TSMC Session - Complete Process Technology Solutions for Smart IoT		
主持人: TSMC 中国业务发展资深经理，韦浩先生 Moderator: Mr. Harry Wei , Senior Manager, Business Development, TSMC		
14:30-14:45	引言 Opening Introduction	TSMC 中国业务发展资深总监，陈平博士 Dr. Peter Chen, Senior Director, Business Development, TSMC
14:45-15:15	超高速工艺与应用 High-performance Technology & Applications	TSMC 中国业务发展客户经理，孔玲 Yoyo Kong, Account Manager, Business Development, TSMC
15:15-15:45	TSMC 超低功耗工艺与应用 TSMC Application Driven Ultra-low Power Technology	TSMC 中国业务发展技术经理，邬婷 Tina Wu, Technical Manager, Business Development, TSMC
15:45-16:15	TSMC 安全和联接芯片专用工艺 TSMC Technology for Security and Connectivity	TSMC 中国业务发展技术经理，何瑞灵 Ray He, Technical Manager, Business Development, TSMC
16:15-16:45	设计环境和支持 Ecosystem for Design Enablement	TSMC 中国业务发展技术经理，卓铭 Ming Zhuo, Technical Manager, Business Development, TSMC

16:45-17:00	问答时间 & 抽奖 Q&A and Lucky Draw
18:00-20:00	闭幕招待晚宴 Closing Reception Banquet 地点：天津赛象酒店 Site: Tianjin Saixiang Hotel

2015 年 12 月 11 日, 星期五
Dec 11, Friday, 2015
专题论坛 (四)
Subject Forum (IV)

地点: 天津梅江会展中心二楼 216 会议室

Venue: Meeting Room 216, 2/F, Tianjin Meijiang Convention & Exhibition Center

时 间 Time	内 容 Contents	演讲人 Lecturer
IC 设计与封装测试 IC Design and Packaging & Testing		
主持人: 中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长, 赵建忠先生 Moderator: Mr. Zhao Jianzhong, Vice General Secretary, CSIA-ICCAD		
08:40-09:05	先进 MIS 封装技术 Advanced MIS packaging technology	江苏长电科技股份有限公司技术资深总监, 林煜斌 YB Lin, Senior Director of Technology, JCET
09:05-09:30	因应新兴应用的高集成封装方案 High Integration Packaging Solutions for Emerging Applications	南通富士通微电子股份有限公司技术中心主任, 林仲珉 Victor Lin, Director of Technology Center, Nantong Fujitsu Microelectronics Co., Ltd.
09:30-09:55	R&S 先进的 IC 测试方案, 让设计变得更简单 R&S Advanced IC Test Solution - Making the Design More Simple	罗德与施瓦茨(中国)科技有限公司业务发展主管, 杨洪文 Yang Hongwen, Business Development Supervisor, Rohde & Schwarz (China) Technology Co., Ltd.
09:55-10:20	晶圆级先进封装技术及市场趋势 Wafer Level Package Technology and Market trends	宁波芯健半导体有限公司常务副总经理, 谢皆雷 Jerry Xie, Executive Vice General Manager, NINGBO CHIPEX SEMICONDUCTOR CO., LTD
10:20-10:45	物联网与无线装置的系统级封装解决方案 SiP for Connectivity & IoT	日月光集团研发中心技术副处长, 郑民耀 Eddie Cheng, Deputy Director, Corporate R&D, ASE Group
10:45-11:10		苏州晶方半导体科技股份有限公司
11:10-11:35	物联网测试的挑战与方案 IoT test challenges and solutions	爱德万测试(中国)管理有限公司专家工程师, 胡佳明 Hu Jiaming, Expert Engineer, Advantest (China) Co., Ltd.
11:35-12:00	消费电子的低成本封装方案 The Low Cost Package Solution for Consumer Electronics	江阴长电先进封装有限公司市场业务经理, 缪志翰 Gemini Miao, Sales & Marketing Manager, Jiangyin Changdian Advanced Packaging Co., LTD

12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw	
12:05-13:00	自助午餐 Buffet Lunch	
13:00-13:25	3D WLCSP 市场与技术发展动态	华天科技（西安）有限公司技术总监，于大全 Yu Daquan, Technical Director, Hua Tian Technology (Xi'an) Co., Ltd.
13:25-13:50	国产塑封料的现状与未来 Present and Future of Domestic EMC	江苏华海诚科新材料有限公司总经理，韩江龙 Han Jianglong, CEO, Jiangsu HHCK Advanced Materials Co., Ltd.
13:50-14:15	安靠 SIP 技术在物联网中的应用 Amkor SiP technology for IoT	Amkor 中华区市场部总监，李吕祝 John Lee, Amkor
14:15-14:30	茶歇，交流 Coffee Break	
资本与 IC 设计业 Capital and IC Design Industry		
主持人：中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，孙坚女士 Moderator: Ms. Sun Jian, Vice General Secretary , CSIA-ICCAD		
14:30-17:00	<p>现代制造业东移，集成电路制造的投资与技术向中国方向转移已渐成趋势；“国家集成电路产业发展推进纲要”（以下称“发展纲要”）明确大力支持中国集成电路制造技术和产业发展，显然打造能支撑中国 IC 市场需求的集成电路制造业，是规划纲要的最主要目标；近年来，中国集成电路设计行业在技术水平、产品品类和销售量方面快速增长，已经成为国内 IC 产品发展的带动力量，在“发展纲要”的指导下，如何进一步快速发展中国 IC 产业的龙头力量，如何在激烈的竞争中，借助金融的力量，走出金融、技术、市场的全球化之路。</p> <p>通过此次 IC-VC 论坛，围绕“金融如何助力中国 IC 设计业走出全球化之路”的主要探讨以下几个问题：在发展纲要推动的产业环境中，作为后起之秀的中国 IC 设计业如何走出全球化之路的机会；如何更好的结合《发展纲要》着力提升的中国 IC 产业链；中国 IC 市场的独到机会与金融之手如何串起市场、技术、产业支撑，发展中国的 IC 设计业。</p>	
17:00-17:05	总结 & 抽奖 Closure and Lucky Draw	
18:00-20:00	闭幕招待晚宴 Closing Reception Banquet 地点：天津赛象酒店 Site: Tianjin Saixiang Hotel	

2015 年 12 月 11 日，星期五
Dec 11, Friday, 2015
专题论坛（五）
Subject Forum (V)

地点：天津梅江会展中心二楼 219 会议室

Venue: Meeting Room 219, 2/F, Tianjin Meijiang Convention & Exhibition Center

时 间 Time	内 容 Contents	演讲人 Lecturer
IC 产业发展的芯模式		
主持人：芯愿景软件有限公司销售总监，石子信先生 Moderator:		
08:40-08:55	领导致词	天津开发区管委会主任
08:55-09:15	领导致词	中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长，魏少军教授
09:15-09:30	中国促芯腾飞，泰达助芯发展	天津泰达科技发展集团总工程师，马萱
09:30-09:55	集成电路反向工程最新状况及发展趋势 The New Status and Development Tendency of IC Reverse Engineering	芯愿景软件有限公司总经理，张军 Zhang Jun, CEO, Cellixsoft Corporation
09:55-10:20	基于可信芯片构建安全可信移动智能终端	天津国芯科技有限公司副总工程师，艾方
10:20-10:45	英特格灵—节能环保芯	英特格灵芯片（天津）有限公司 CEO，高峰
10:45-11:10	信息系统体系架构变革与软件定义互连	国家数字交换系统工程技术研究中心 SOC 研发部主任，刘勤让博士
11:10-11:35	28Gb 以上的高速 SerDes 设计技术	深圳市中兴微电子技术有限公司网络芯片首席模拟架构师，郭春炳博士
11:35-12:00	IC 产业投资环境现状	深圳市创新投资集团有限公司副总经理
12:00-12:05	幸运抽奖 Lucky Draw	
12:05-13:00	自助午餐 Buffet Lunch	

会议日程以最终现场公布为准。